



# 深圳市聚科达电子材料有限公司

SHENZHEN JUKEDA ELECTRON MATERIALS CO., LTD.

ADD: 深圳市光明新区公明镇李松荫村第二业区如宇富明科技园 TEL:086-0755-27106461

Ruyufuming Industry Park, Lisonglang Village,,Guangming

FAX:086-0755-27105167

New Area, Shenzhen City, China.

## JKD-902-H、COB、集成封装胶技术规格书

### 一、产品功用及特点:

JKD-902 是一款加成型中温固化有机硅封装胶,是各种大功率集成 COB 的专用封装硅胶,胶体具有固化快,固化后具有良好的硬度和韧性,耐高低温性能,附着力强,不龟裂,还具有透光率高,折射率高、热稳定性好、应力小、吸湿性低等特点,胶体的具体特点如下:

- 1、其具有优异的抗候性能,可在-60--250℃范围内长期使用;
- 2、具有优异的附着力,对 PCB、PPA、金属等都能很好的粘接;
- 3、具有优异的透光率和折射率,透光率>95%,折射率>1.41;
- 4、具有应力小,吸湿性低等特点,能最大限度的保证封胶后的稳定性;
- 5、具有较高的硬度,硬度大于 55A。

### 二、主要技术参数:

技术参数	主要数据
固化前	
外观	A: 无色透明 B: 半透明液体
粘度 (CPS)	A: 5500±200, B: 3200±200
混合粘度 (CPS)	4000±200
可操作时间 (25℃)	8-10hr
固化时间 (80℃/150℃)	1hr/4hr
固化后	
透光率	95.3%
折射率	1.41
邵氏硬度 (HA)	55-58
热膨胀系数 (w/m.k)	<160PPM/℃
拉伸强度	6.3 MPa
介电常数	3.5

体积电阻率	$>1.0 \times 10^{15}$
-------	-----------------------

备注：以上数据为实验室即时检测数据，部分数据可能会因不同检测仪器之间的误差而有所不同，最终数据以客户实测数据为准。

### 三、使用方法：

- 1、将 A、B 两个组分的胶水按照重量比 1:1 的比例混合均匀；（混胶时一定要保证不带入其余杂质，最好用干净的专用容器以及搅拌棒）；
- 2、将混合好的胶水放进排泡装置中进行排泡，待气泡排除完毕后再进行封装灌封；
- 3、封胶后应先在 80℃ 烘烤 1 小时，然后将温度提高到 150℃ 烘烤 4 小时，待胶体完全固化后，让其自然冷却至常温即可进行后续操作；

注意：整个操作建议在干燥无尘的环境中进行，封胶前需对支架进行高温处理（150 度烘烤 1-2 小时除湿）。

### 四、注意事项：

- 1、添加荧光粉后应保证与胶水完全混合均匀；
- 2、本胶水不能与其它胶水混用；
- 3、混合好后的胶水必须进行排泡处理；
- 4、脱泡时，待肉眼看不到气泡即可，应避免脱泡时间过长使胶水温度升高而造成胶体可操作时间减少，已配好的胶尽量在 10 小时内用完；
- 4、封胶后一定要按照 80 度先烘烤 1 小时，然后升温到 150 度烘烤 4 小时，以避免直接高温烘烤造成表面起皱影响美观。

### 五、特别提醒：

某些材料和物质可能会阻碍胶水的固化必须避免接触此类物质，这些物质包括：

- 1、 橡胶手套等橡胶类物质；
- 2、 有机锡和其它有机金属化合物；
- 3、 硫、聚硫化物、或其它含硫化合物；
- 4、 胺、聚氨酯橡胶或含氮化合物；
- 5、 磷、亚磷或含亚磷化合物；
- 6、 某些助焊剂残留物。

如果对某种基材是否会阻碍胶水固化存在疑问，可做相容性实验来测试，如果疑问基材与胶体之间存在不固化胶体说明此基材会阻碍固化，不能使用。

●以上技术信息仅供参考，使用前请进行充分的必要性测试，以上介绍的用途无法保证是否有抵触的专利问题。我司材料是针对与一般工业用途开发的产品，如有其它特殊用途请先进行测试。